

【証券コード：6728】

2016年度 第2四半期（累計） （2016年7月 12月） 決算説明会資料

2017年2月14日
株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ（FPD）・半導体・太陽電池・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

（特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです）

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q（累計）： 第2四半期連結累計期間

2Q： 第2四半期連結会計期間

年度： 当社会計年度（16年度：16/7 17/6）

2016年度第2四半期（累計）連結業績概要

2016年度上期のハイライト

□ **受注高 1,118億円（当初予想比 + 20%）**
- 大型TV（LCD）、OLED（有機EL）、半導体メモリ、電子部品
向け投資が想定以上に活発化。

□ **売上高 1,120億円（当初予想比 + 11%）**
- 受注高の増加により予想を上回る実績。

□ **営業利益 144億円（当初予想比 + 37%）**
- 売上高の増加により予想を上回り、半期での最高益を達成。

□ 通期業績予想を上方修正

	当初予想	今回修正予想
売上高	1,940億円	2,185億円
営業利益	180億円	260億円
当期純利益	120億円	195億円

2016年度2Q（累計） 連結業績概要

市場環境とアルバックの強み

2016年度連結業績予想

受注高、売上高、各利益項目とも、全てで前年同期を上回る。

- ・ 売上高 : 前年同期比9%増。FPD製造装置の増加が主因。
- ・ 営業利益 : 前年同期比34%増。売上高の増加が寄与。

【単位：億円】

	(参考) 2015年度実績			2016年度2Q (累計)			
	上期	下期	通期	当初予想*	実績	対前年同期 増減率	当初予想比 増減率
受注高	1,060	1,176	2,236	930	1,118	5.5%	20.2%
売上高	1,028	897	1,924	1,010	1,120	9.0%	10.9%
売上総利益	270	241	511	-	313	15.8%	-
率	26.3%	26.9%	26.6%	-	27.9%	+ 1.6 pt	-
販管費	162	170	333	-	169	4.0%	-
営業利益	108	71	179	105	144	33.6%	37.2%
率	10.5%	7.9%	9.3%	10.4%	12.9%	+ 2.4 pt	+ 2.5 pt
経常利益	107	77	184	105	146	36.6%	39.4%
率	10.4%	8.5%	9.5%	10.4%	13.1%	+ 2.7 pt	+ 2.7 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	78	89	167	75	113	44.9%	50.7%
率	7.6%	9.9%	8.7%	7.4%	10.1%	+ 2.5 pt	+ 2.7 pt

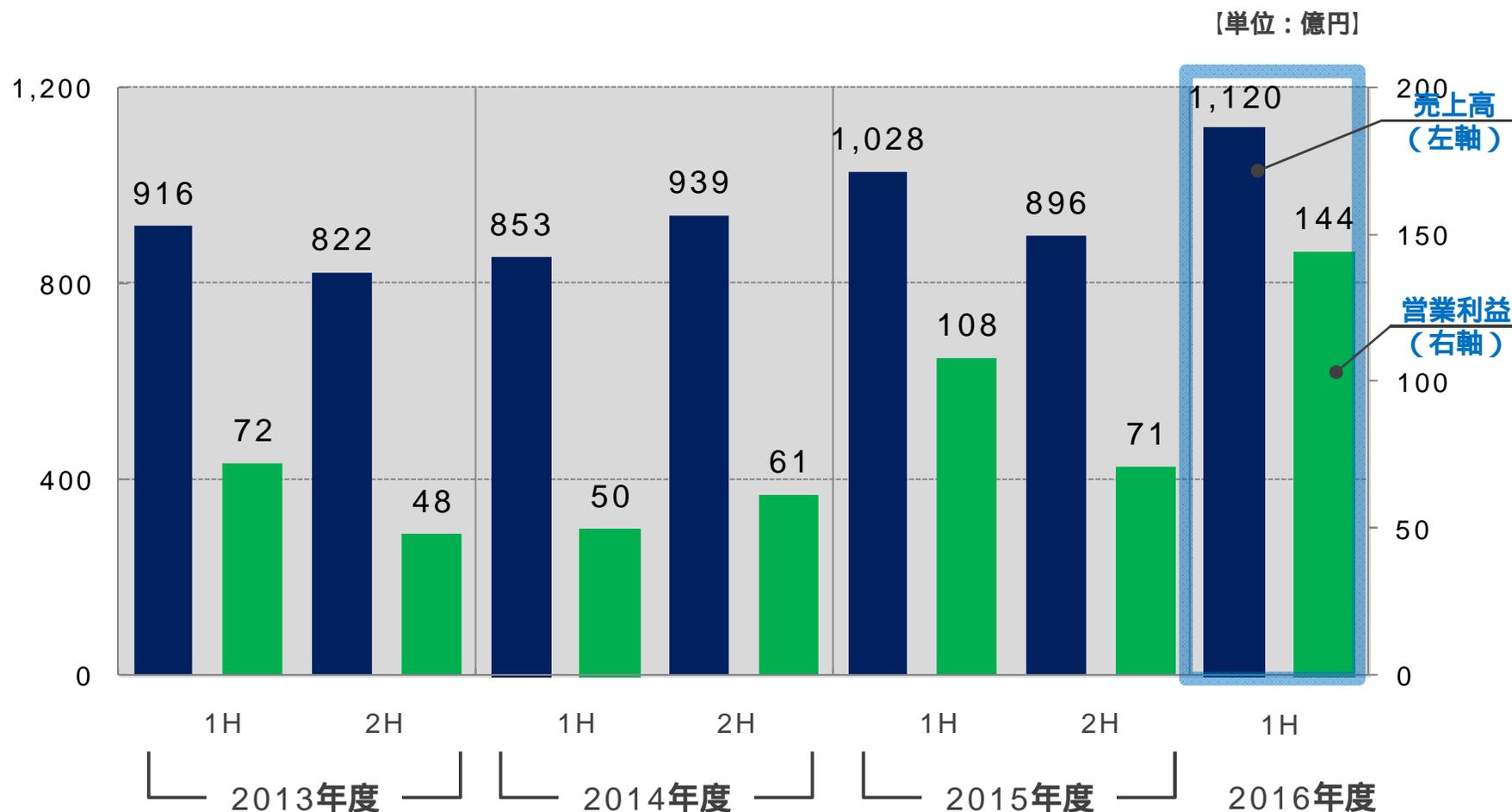
* : 2016年8月公表値

2016年度2Q（累計）連結業績概要 （売上高と営業利益の推移）

市場環境とアルバックの強み

2016年度連結業績予想

売上高・営業利益とも堅調に推移し、営業利益は半期での最高益を達成。



2016年度2Q（累計）連結業績概要 （品目別受注高・売上高実績）

市場環境とアルバックの強み

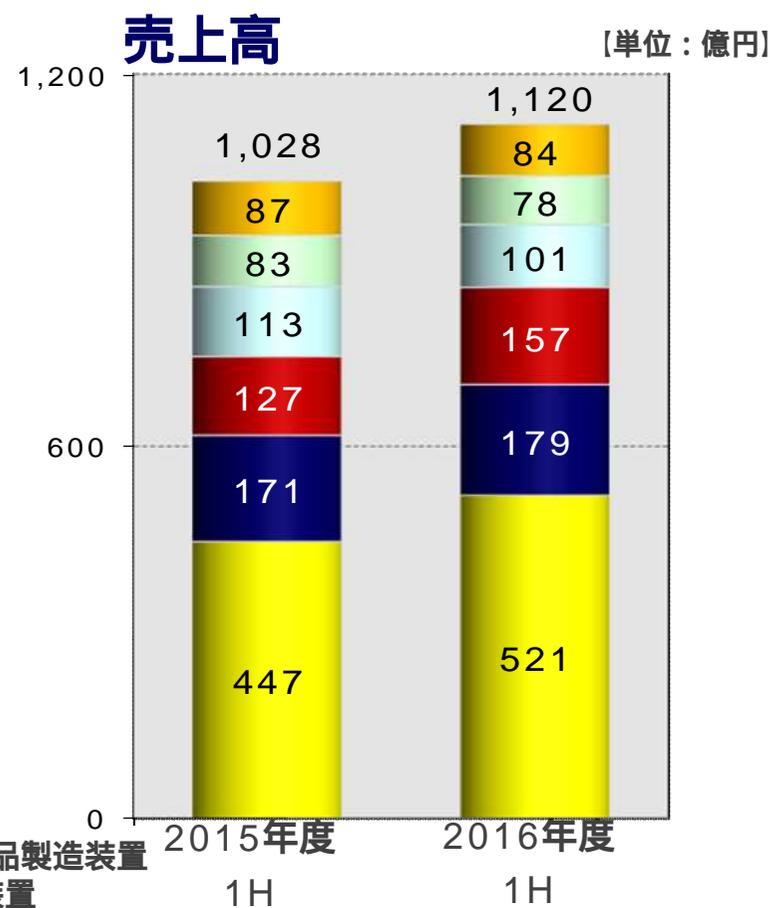
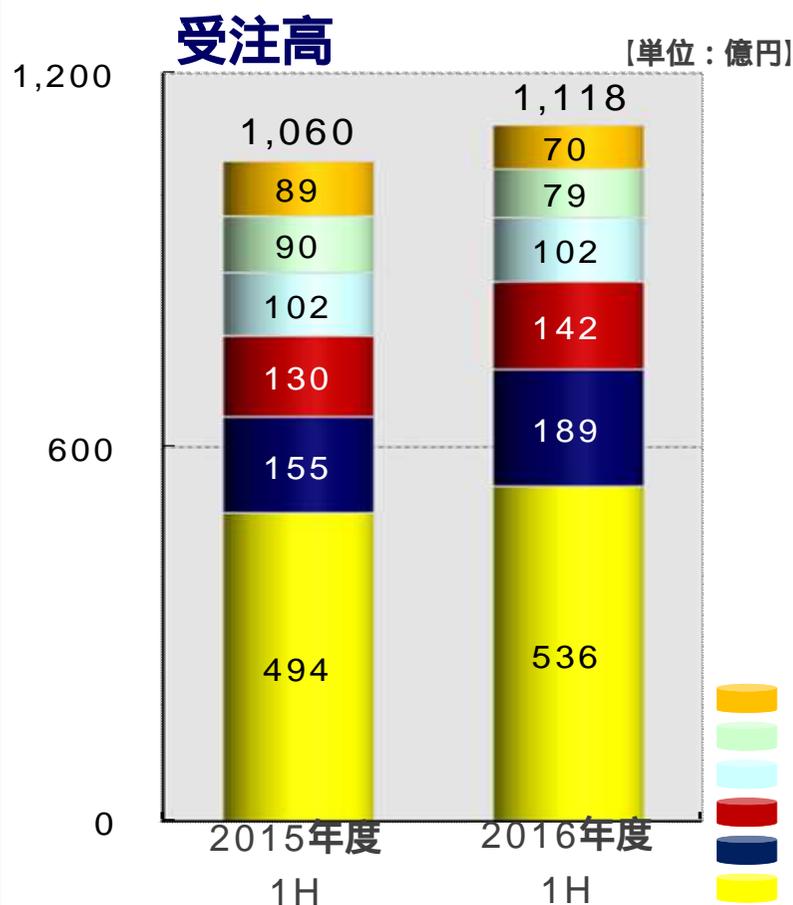
2016年度連結業績予想

全体では、前年同期比6%増

- ・ FPD製造装置：OLED向け投資が拡大
- ・ 半導体・電子部品製造装置：メモリ（NAND、DRAM）向け投資が拡大
- ・ コンポーネント：OLED向けクライオポンプ等が増加

全体では前年同期比9%増加

- ・ FPD製造装置：OLED製造装置が増加
- ・ コンポーネント：OLED向けクライオポンプ等が寄与



2016年度2Q（累計）連結業績概要 （FPD、半導体・電子受注高 用途別内訳）

市場環境とアルバックの強み

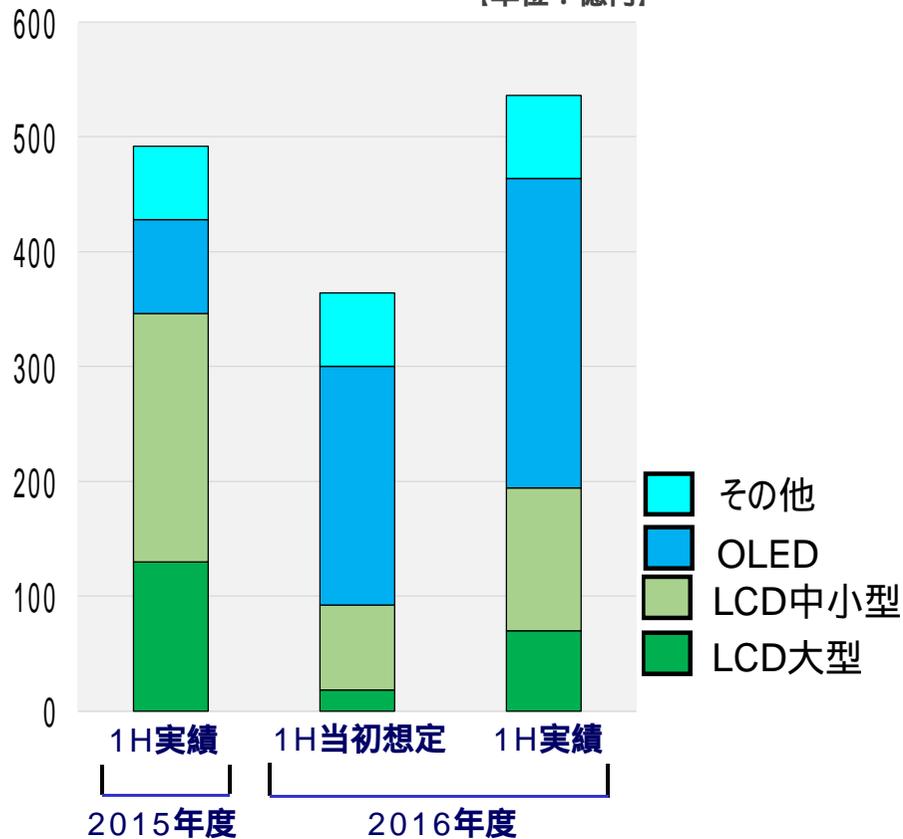
2016年度連結業績予想

- ・ 大型TV向けの前年度前倒しの反動は当初想定比小幅に、今後の投資計画はむしろ拡大傾向。
- ・ OLED向け拡大は当初想定以上。

- ・ 半導体メモリ、高機能電子部品向けを中心に当初想定比増加。

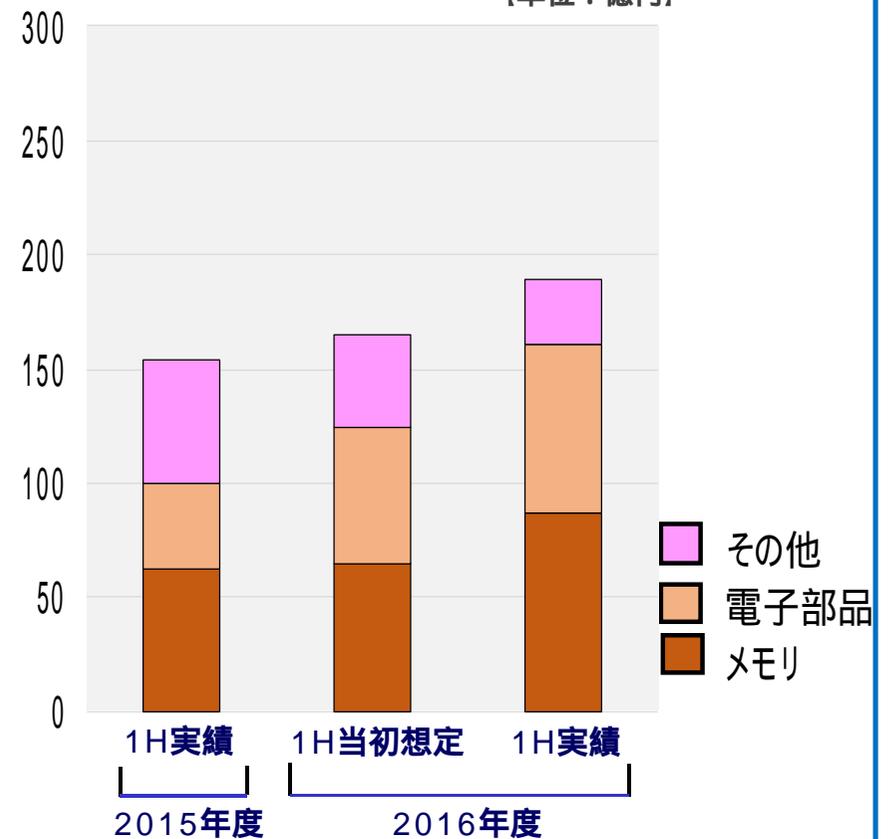
FPD 用途別内訳（受注高）

【単位：億円】



半導体・電子部品 用途別内訳（受注高）

【単位：億円】



2016年度2Q（累計）連結業績概要 （品目別受注高・売上高四半期推移）

市場環境とアルバックの強み

2016年度連結業績予想

・ 受注高・売上高とも2四半期連続で増加

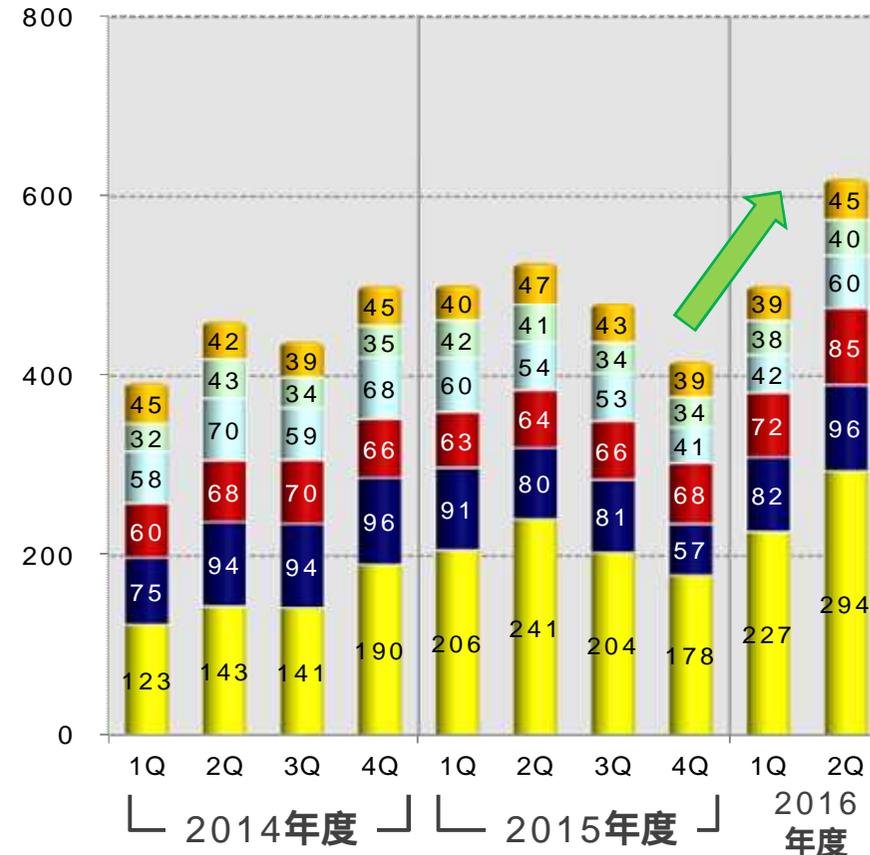
【単位：億円】

受注高



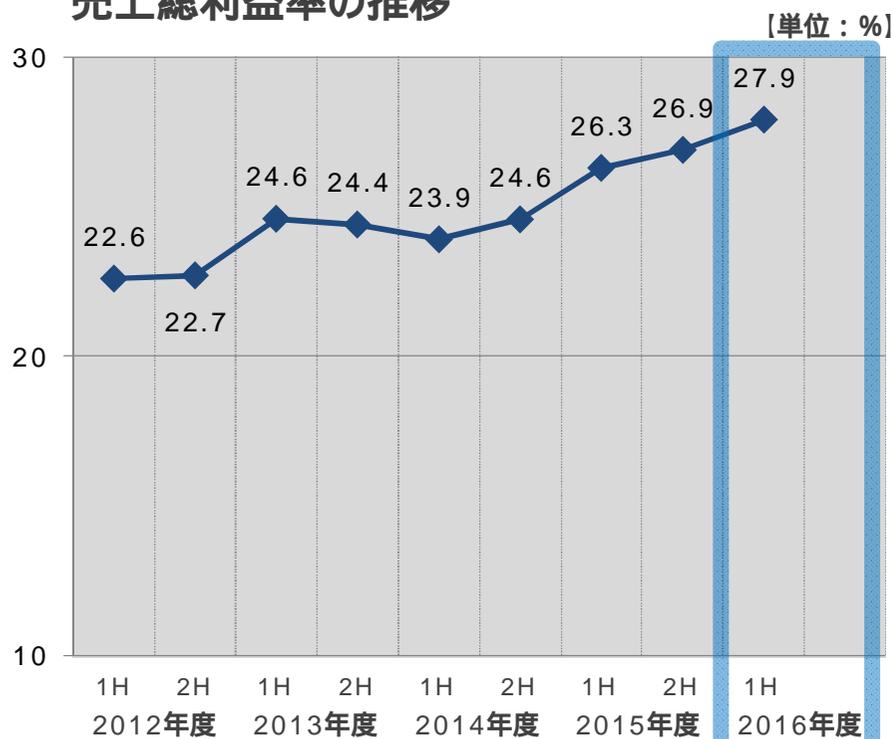
【単位：億円】

売上高

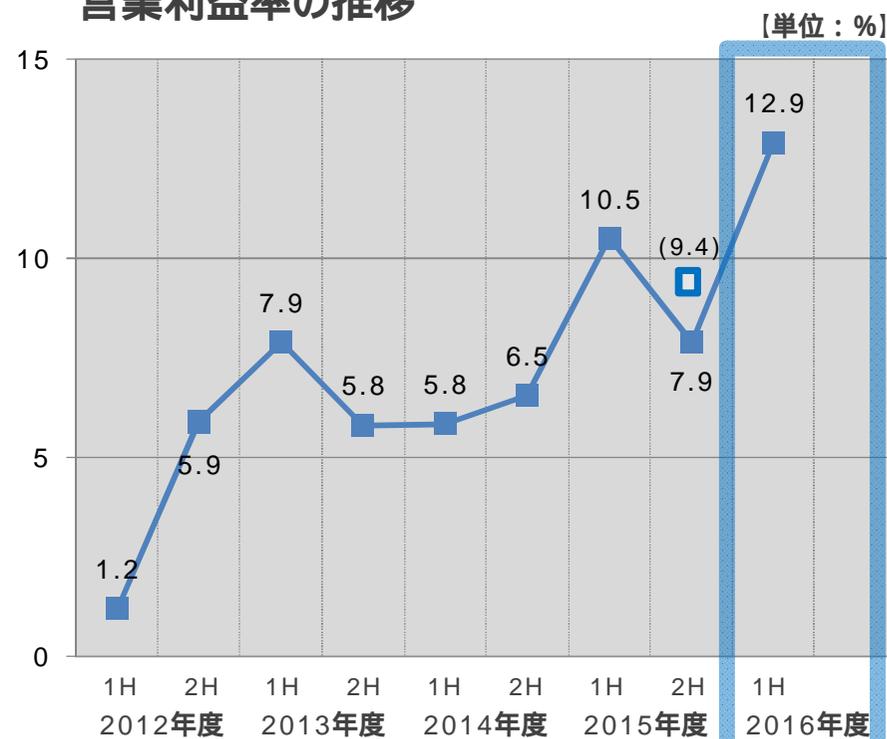


- ・ 売上総利益率、営業利益率ともに上昇。営業利益率は12.9%に。

売上総利益率の推移



営業利益率の推移



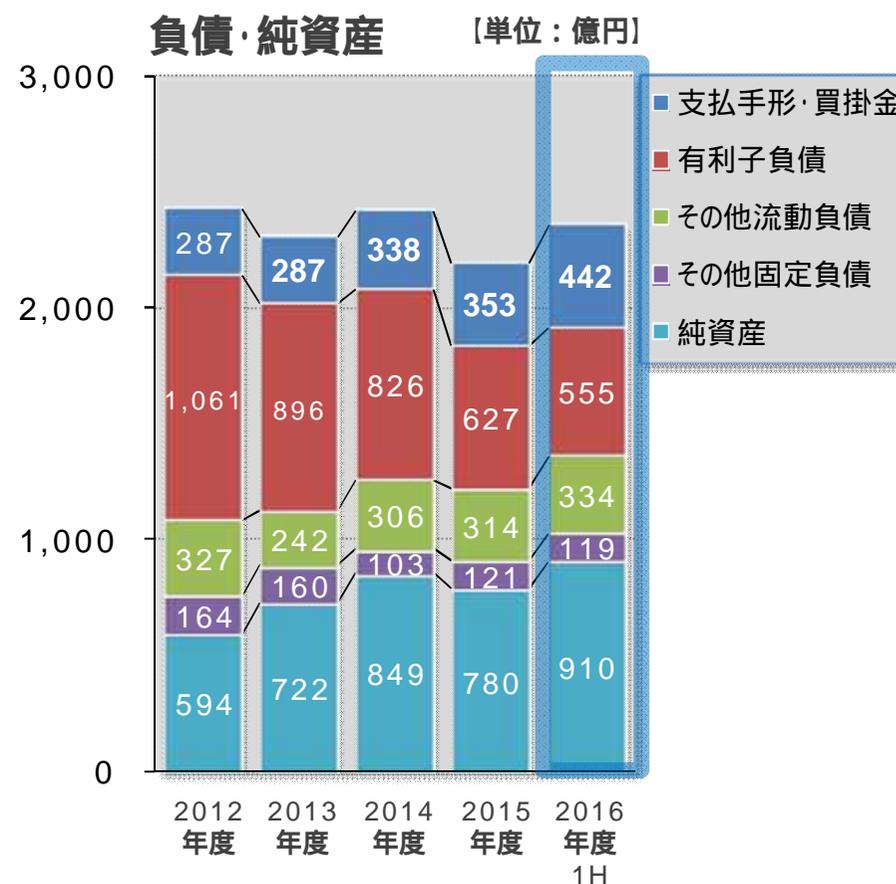
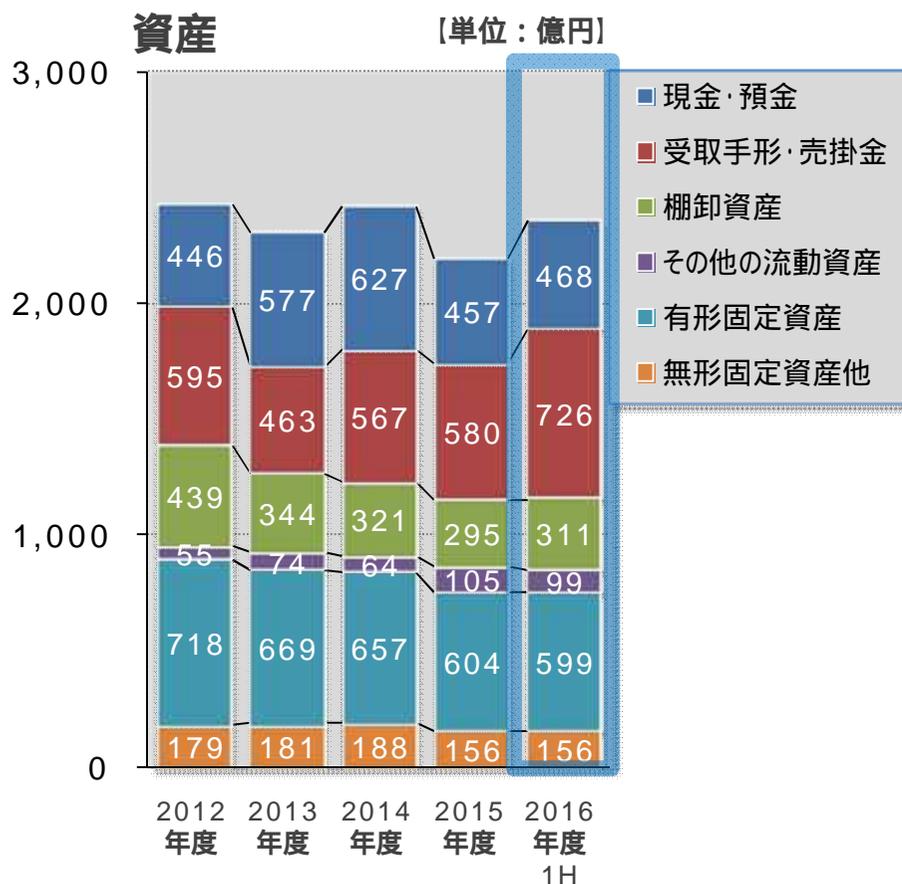
□ 2015年度2Hは、貸倒引当金を除くと9.4%

2016年度2Q（累計）連結業績概要 （連結貸借対照表）

市場環境とアルバックの強み

2016年度連結業績予想

- ・ 売上高増加に伴い、前年度末比で受取手形・売掛金が146億円、支払手形・買掛金が89億円、各々増加。
- ・ 有利子負債は72億円減少、純資産は130億円増加。



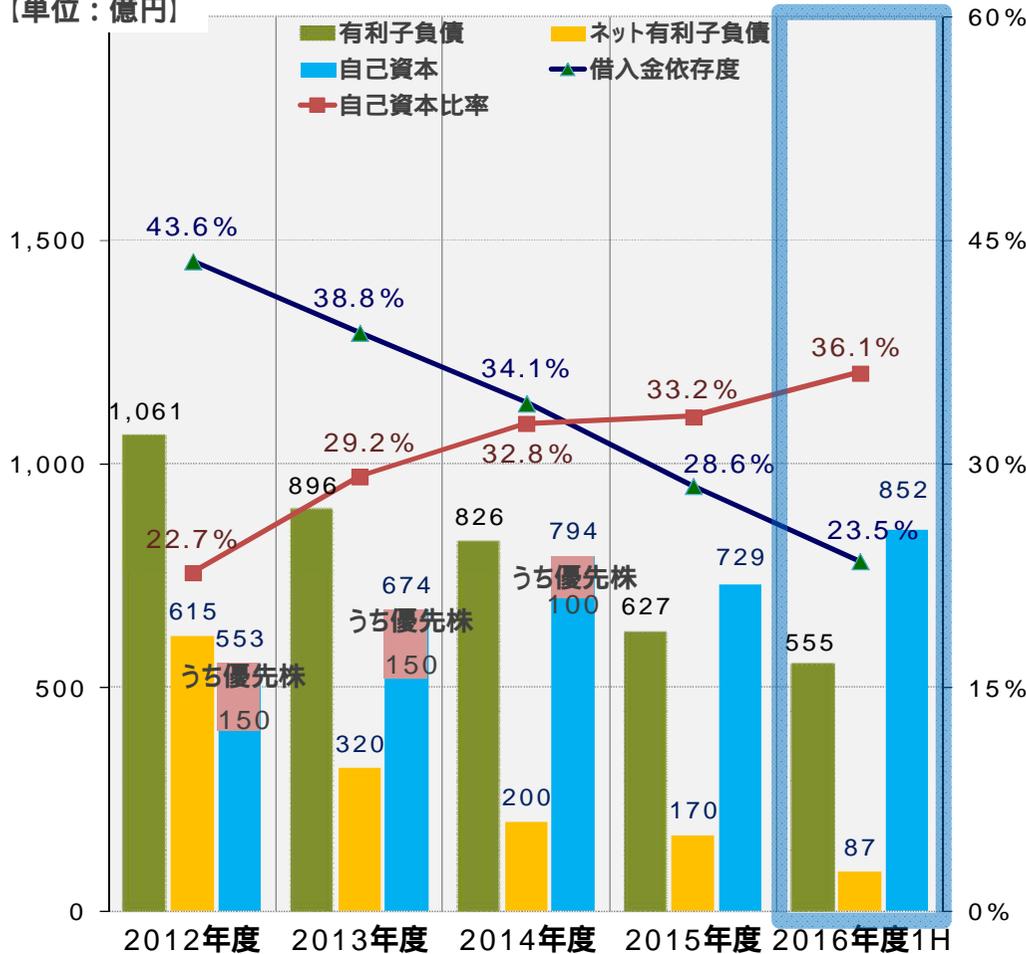
2016年度2Q（累計）連結業績概要 （有利子負債の推移とキャッシュフロー）

市場環境とアルバックの強み

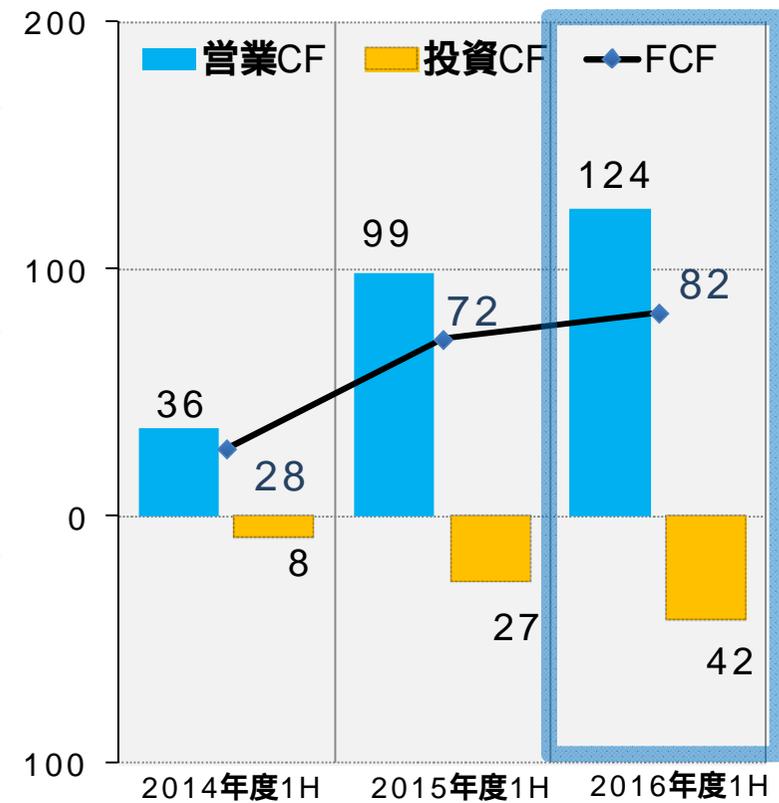
2016年度連結業績予想

- ・ 借入金依存度が23.5%に低下。
- ・ 自己資本は123億円増加し852億円となり、自己資本比率が36.1%に上昇。
- ・ 営業CFは124億円、FCFは82億円となり、前年同期比増加。
- ・ ネット有利子負債は87億円に減少。

[単位：億円]



[単位：億円]

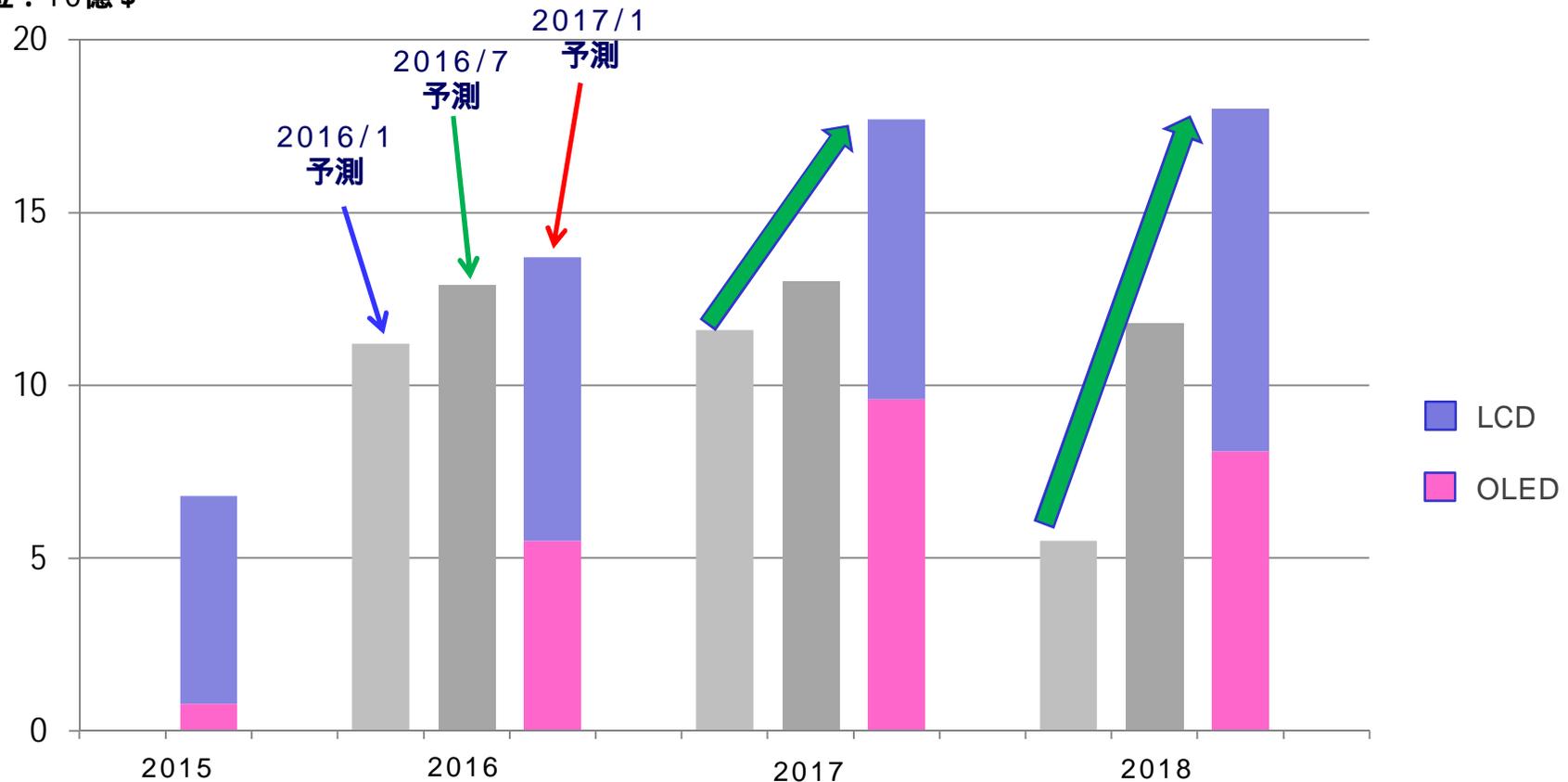


市場環境とアルバックの強み

FPD製造装置の設備投資予測は大幅に上方修正

スマホ向けOLED投資、大型TV向け投資ともに好調で、
2018年に向けて投資計画は大幅に増加。

単位：10億\$



* IHS Markit資料から抜粋し作成 FPD製造装置設備投資予測(工場、付帯設備等除く)

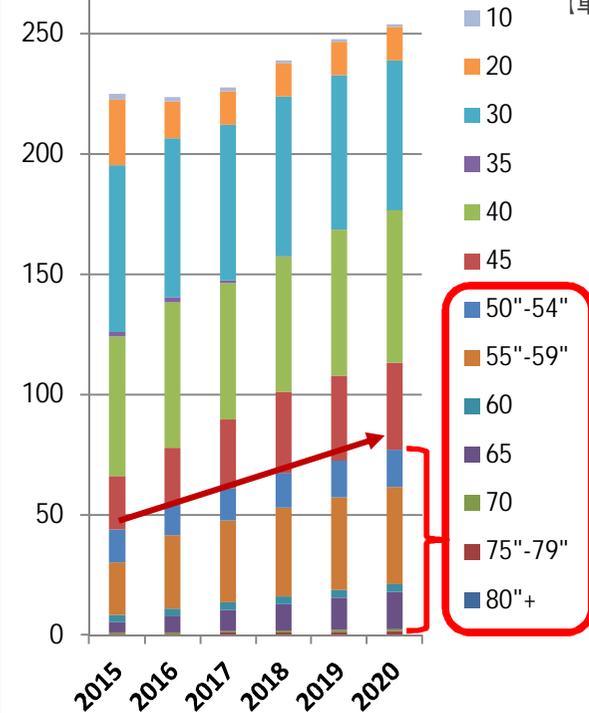
50インチ以上の大型TV需要が増加

大型TV向けG10.5 (2.9m x 3.4m) の設備投資が
中国を中心に活発化

バックプレーン用 スパッタ装置G10以上 アルバックシェア = 100%

薄型TVサイズ別需要予測

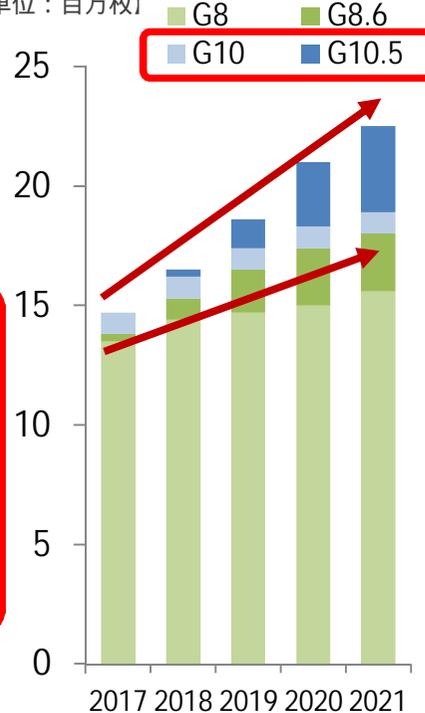
[単位:百万枚]



< IHS Markit資料から抜粋し作成 >

大型LCD基板 (G8以上)
ガラスサイズ別生産能力

[単位:百万枚]



< IHS Markit資料から抜粋し作成 >

<アルバックの強み>

- ・生産性に優れたスパッタカソードを提供
- ・インライン式固定成膜により、生産性と信頼性を両立
- ・優れたスペース効率

中国市場での優位性

- ・カスタマーサポート体制 (12拠点)
- ・現地生産体制 (サプライチェーン構築)

市場環境とアルバックの強み (FPD/大型TV)

2016年度2Q連結業績概要

2016年度連結業績予想



中国 蘇州工場 クリーンルーム



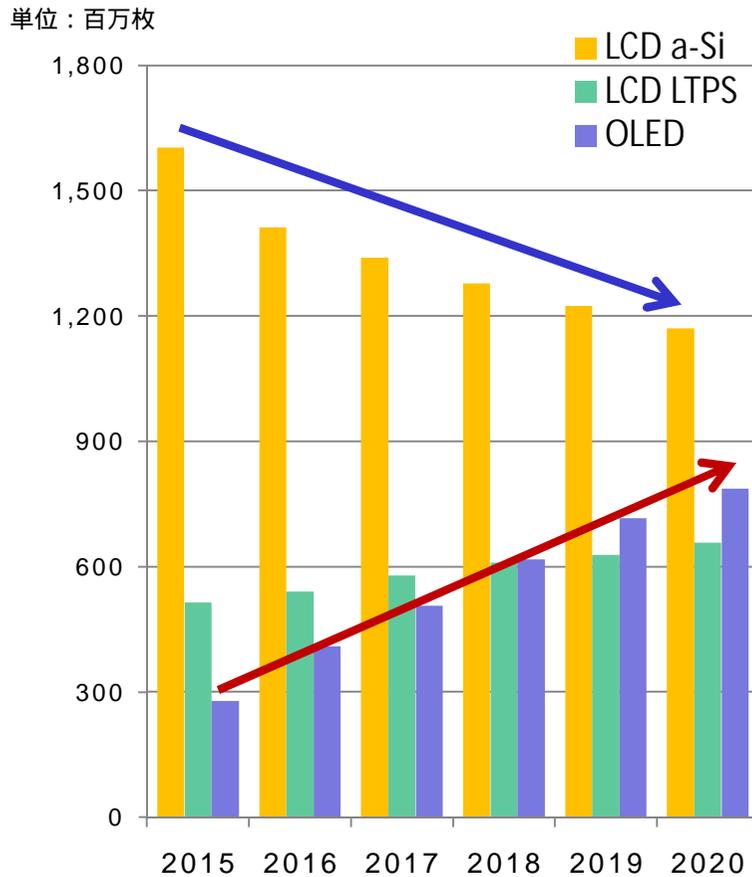
他社にさきがけ、中国拠点において 大型FPD製造装置を生産

- ✓ サプライチェーンを育成・構築
- ✓ 高品質な装置製造技術（顧客認定取得）
- ✓ 大型クリーン工場
- ✓ 人材育成（日本で品質・技能研修）

スマホ向けでOLED需要が急増

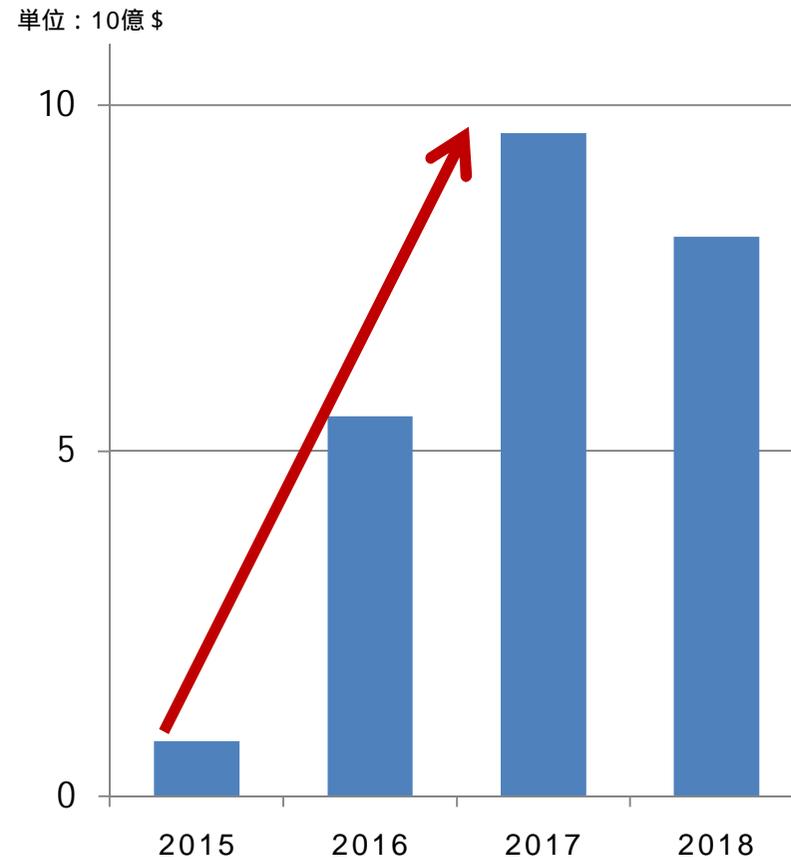
OLED向け設備投資活況

中小型パネル 出荷数量予測



< IHS Markit 資料から抜粋し作成 >

OLED製造装置 設備投資予測



< IHS Markit 資料から抜粋し作成 >

市場環境とアルバックの強み (FPD/OLED)

2016年度2Q連結業績概要

2016年度連結業績予想

**OLED製造の主要な成膜工程に装置を提供
装置、プロセス、コンポーネント、フィールドサポートまで、トータルサポート**

成膜装置

工程

LTPS (IGZO)
(Back Plane)

有機EL蒸着
(Front Plane)

薄膜封止

タッチセンサー

スパッタ装置
SMD シリーズ

蒸着装置
ZELDA シリーズ

封止装置
CEE シリーズ

インライン式スパッタ装置
STD シリーズ
巻取式スパッタ装置
SPW シリーズ

PECVD装置
CMD シリーズ

各種プロセスにマッチング
した製造装置を開発

次世代に向けた
技術開発の取組み
(蒸着装置)

- ・高精細化
(1000ppi、シャドウ最小化)
- ・高精度アライメント
(画像処理技術、高信頼性)
- ・蒸発源
(高効率化、均一性)
- ・基板サイズ大型化対応

コンポーネント



- ・真空ポンプ・クライオポンプ
- ・スパッタ電源・成膜コントローラ
- ・残留ガス分析器・リークディテクタ等

サポート

- ・フィールドサポート
- ・スパッタターゲット
- ・部品洗浄、消耗品等

OLED向けクライオポンプの出荷は大幅に増加 シェアをほぼ独占

OLED向け出荷台数推移



アルバックの強み

各種装置に合わせた設計が可能
韓国、中国、国内での生産、
保守・サービス

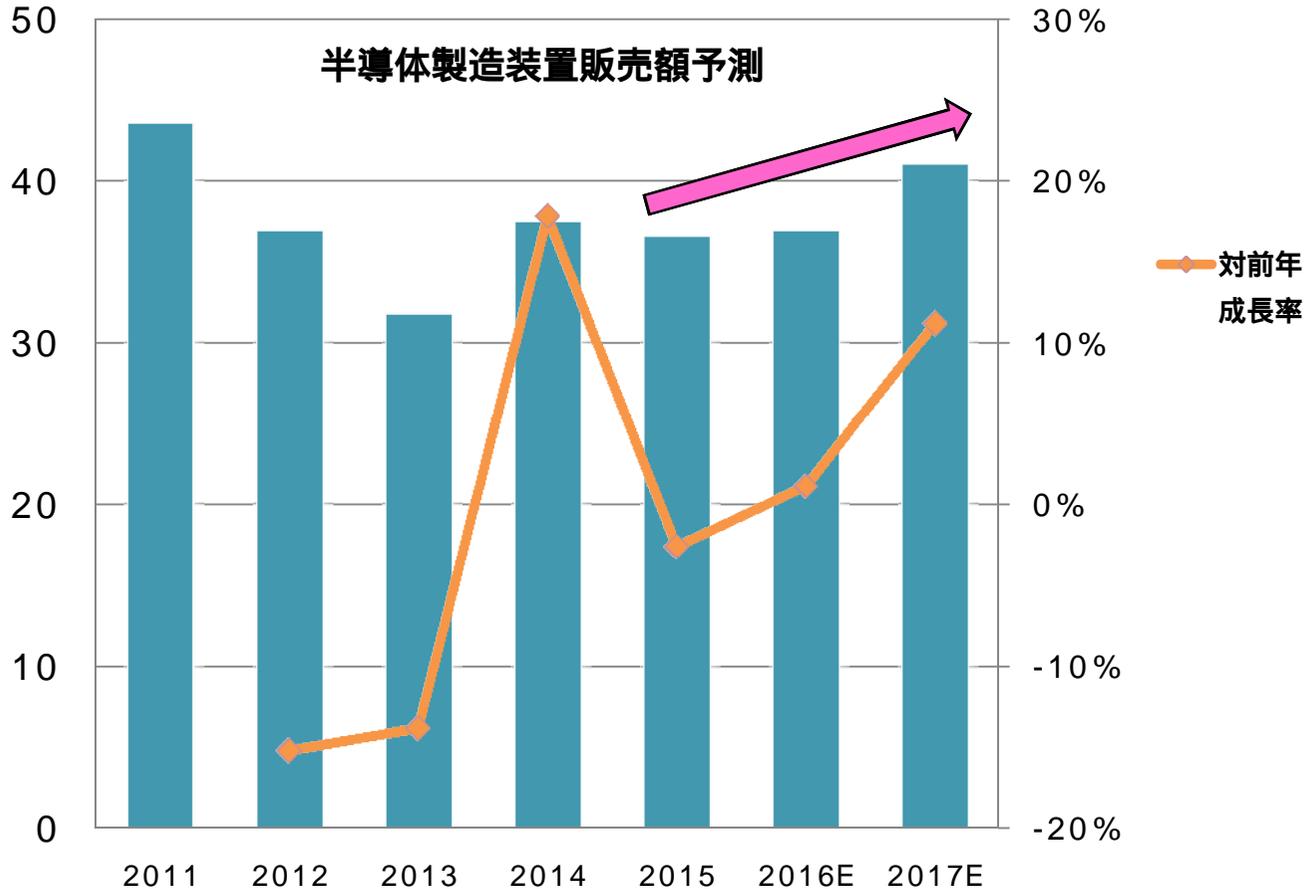
真空蒸着装置で形成する有機EL層は、
極端に水分を嫌う性質から、装置には水分の
排気性能に優れたクライオポンプが搭載され
る。

半導体・電子部品製造装置販売は増加傾向

半導体：3D- NAND投資活発化

電子部品：通信Device、Power Device、高密度実装に動き

単位：10億\$ 50



<SEMI資料「半導体製造装置（新品）販売額予測から作成>

アルバックの半導体・電子部品製造装置

DRAM・NAND

サーバーやモバイル機器向け需要拡大中。
 上期受注実績は、前年同期比で1.4倍に増加。

スパッタ装置、
 自然酸化膜除去装置



パワーデバイス

中国では、エコカー、電車等への搭載に向け国産化が急速に進行。
 IGBT、SiC、(GaN) など、すべてのデバイス向け装置を提供。
 急拡大する中国SiC市場では、イオン注入装置を独占。

成膜装置、
 イオン注入装置
 エッチング装置



通信デバイス

モバイル機器の増加やIoTの加速による周波数帯の拡大により
 通信用フィルター生産数量が増加。
 成膜装置等の増設や更新が加速

成膜装置
 エッチング装置



アルバックの半導体・電子部品製造装置

次世代 不揮発性 メモリ

PcRAMが量産面で先行。
順次装置納入継続中。
メモリーメーカー各社へR&D装置を納入済。
ReRAMやSTT-MRAM向けモジュールモ
ラインナップ。
今後の成長分野として期待。

スパッタ装置



高密度 実装

微細化ニーズの高まりから、実装の高密
度化が加速。WLP*分野では、アッシング
装置の納入実績多数。
今後、WLPの拡大やPLP**への展開で
受注増。

スパッタ装置、
アッシング装置



*WLP : Wafer Level Packaging **PLP : Panel Level Packaging

ロジック・ ファブリー

顧客ニーズに合わせた装置、プロセスを
提供。複数顧客にて次世代向けプロセス
評価中。

スパッタ装置



センサー

IoTの拡大や車載向けにセンサー需要
が拡大。MEMSセンサーや赤外線セン
サー等向けの成膜装置や エッチング装
置を拡販。

成膜装置、
エッチング装置



2016年度連結業績予想

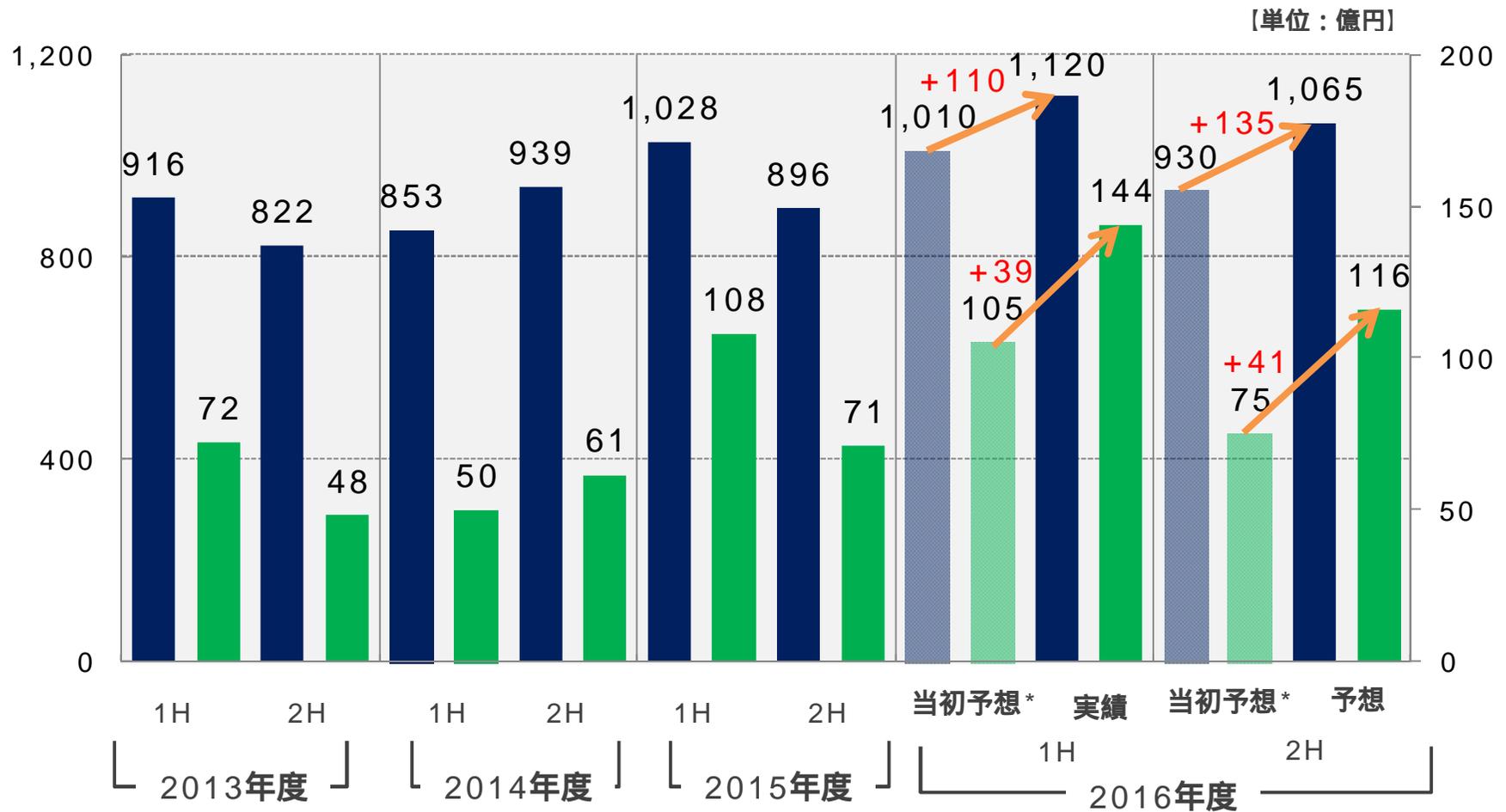
受注高、売上高は上期実績に加え、下期も引続き当初予想を上回る傾向が続くと予想されることから上方修正。

[単位：億円]

	(参考) 2015年度 通期実績	2016年度			
		2Q累計		通期	
		当初予想*	実績	当初予想*	今回予想
受注高	2,236	930	1,118	1,850	2,300
売上高	1,924	1,010	1,120	1,940	2,185
営業利益	179	105	144	180	260
率	9.3%	10.4%	12.9%	9.3%	11.9%
経常利益	184	105	146	180	260
率	9.5%	10.4%	13.1%	9.3%	11.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	75	113	120	195
率	8.7%	7.4%	10.1%	6.2%	8.9%

*：2016年 8月公表値

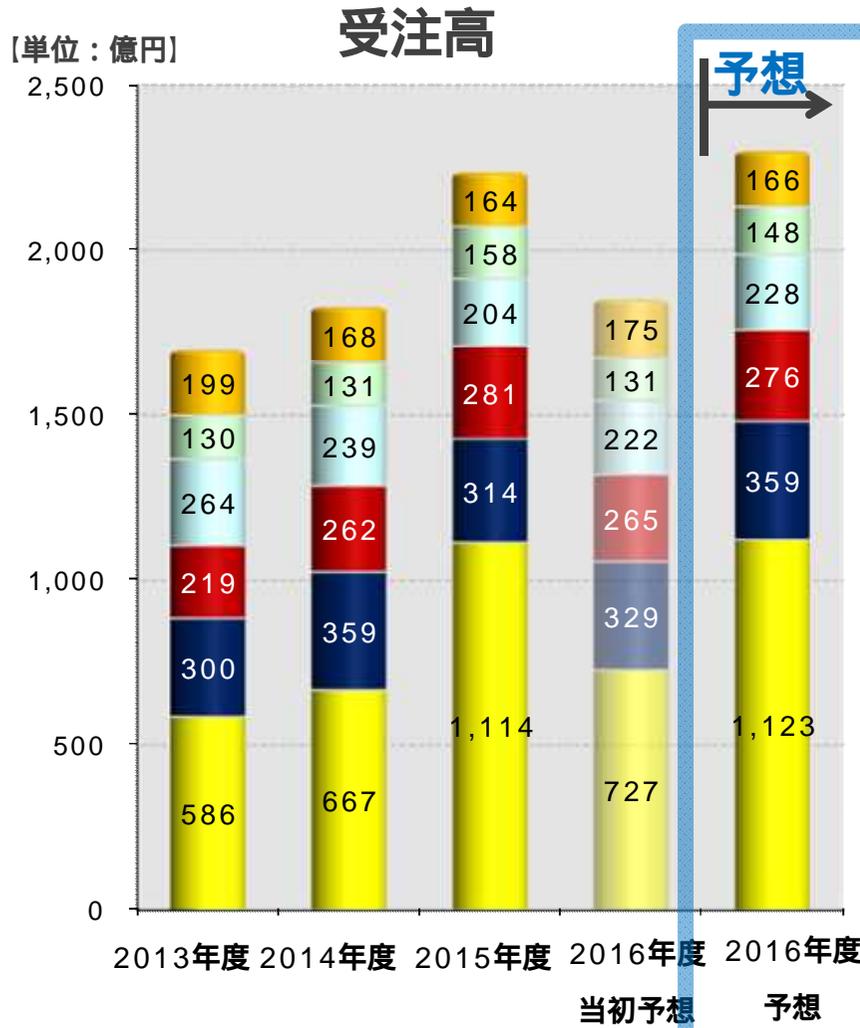
売上高・営業利益は、上期・下期ともに、当初予想比上方修正。



2016年度連結業績予想 (品目別受注高・売上高推移・予想)

2016年度2Q連結業績概要

市場環境とアルバックの強み



- その他
- コンポーネント
- 材料
- 半導体及び電子部品製造装置
- 一般産業用装置
- FPD及びPV製造装置

真空テクノロジーで
「つくる」をつくる、アルバック
ULVAC